

クールプロバイド™ / CPVG

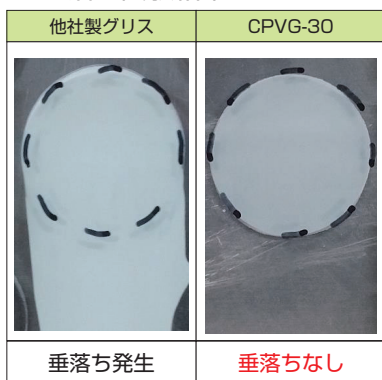


ディスペンサーでの厚塗り可能なパテTIM

特長

- 厚塗りしても垂れ落ちしないTIMです。ヒートスプレッタと高さ違いのICとのGAPを埋めるのに有効です。
CPVG-30: GAP 1mm以下
- パテ状のため(圧縮後の)反発力が小さく、シートタイプに比べIC・基板への負荷を10%以下に抑えられます。
- 1液型で架橋済み材料のため、液ダレが発生しにくいです。
- ディスペンサーでの自動塗布が可能です。
- シリコンフリータイプのためシロキサンガスの発生がなく、オイルブリードが起きにくい製品です。

垂落ち試験結果



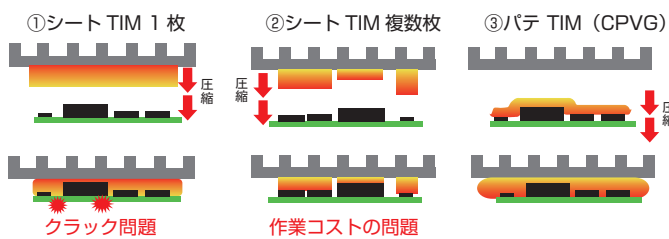
【測定条件】

温度：125℃ 塗布厚さ：t=1mm
時間：1000h 材質：ガラス+アルミ板

(保証値ではありません)

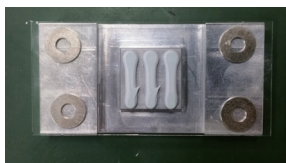
試験項目	単位	規格	CPVG-30
熱伝導率	W/m・K	ISO22007-2 (ホットディスク法)	3.0
熱抵抗	t1.0mm	ASTM D5470	0.33
	t0.3mm		0.08
	t0.1mm		0.01
色調	—	—	グレー
比重	—	JIS Z 8807	2.9
粘度	0.5[1/s]	ASTM D1824準拠	3,300
	1.0[1/s]		2,500
体積抵抗率	Ω・cm	JIS K 6911 準拠	1.0×10 ⁹
絶縁破壊電圧	kV/mm	JIS K 6911 準拠	8
比誘電率	500MHz	社内規格	8.98
	1GHz	社内規格	8.88
難燃性	—	UL94	V-0 相当
使用温度範囲	℃	—	-40 ~ 125
販売形態	—	—	カートリッジ：330ml

CPVG(パテTIM)の作業性とICへの負荷



	①	②	③
作業性	○	×	○ → 放熱部品の位置決めが容易
IC 負荷	×	△	○ → 圧縮時 GAP を埋めるように広がるため IC への負荷低減

③パテ TIM(CPVG) 塗布イメージ



③パテ TIM(CPVG) 取付イメージ

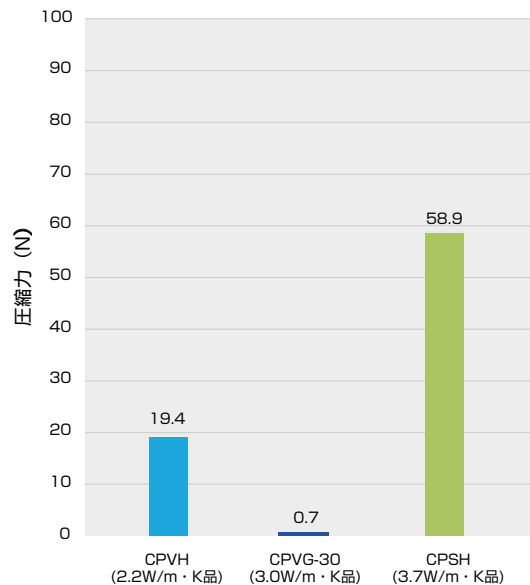


※ディスペンサーの塗布する条件検証を承ります。

■ 対応マシン

メーカー:武蔵エンジニアリング株式会社
機器品番:MS-1D

圧縮力と熱伝導率(シートTIMとの比較)



(注1) 各製品の熱伝導率は、ホットディスク法での数値です。

(注2) 圧縮特性試験
<試験条件>
・ 試料寸法：□10mm×10mm (t2mm)
・ 圧縮率：20%圧縮